



# Orbotech Corus™ 8M

雙面成像，性能最大化



Orbotech Corus 8M 是一款全自動直接成像解決方案，旨在取代傳統的連線直接成像系統。專為最先進的 HDI（包括 mSAP）和 IC 載板量產而設計，能滿足超細線路的成像和出色的對位精度，為 PCB 的設計和生產創造新的機遇。

Orbotech Corus 解決方案採用經由市場驗證的新技術，帶來了極高的產能和良率的同時結合其精巧、密封、乾淨的設計理念，確保了生產過程中對於尖端性能和環保製造的要求。



## 優勢

### 完全整合的自動化解決方案

- 全自動雙面直接成像解決方案旨在取代傳統的連線直接成像系統
- 獨特的光學設計和超強大的多波長雷射系統，適用於超高速成像
- 創新的板材處理和清潔機制

### 卓越的解析度和對位精度

- 超細、高度均勻的線路結構
- 高精密的設計和先進的漲縮演算法確保了卓越的對位精度
- 高景深 (DOF) 確保了在多種高低不均的板上均能實現最佳的線路品質

### 智慧運行

- 高速，多靶點識別功能確保了高產能
- 智慧的料號佇列管理系統，簡化工作流程
- 支援工業 4.0，可實現生產流程最佳化和先進的可追溯性

### 降低整體擁有成本 (TCO)

- 結合大鏡面掃描技術，即時靶點識別功能和高效自動化實現高產能
- 占地面積小，節省無塵室空間並最佳化生產線空間利用率
- 高效的能耗

Technologies



DSI™ Technology

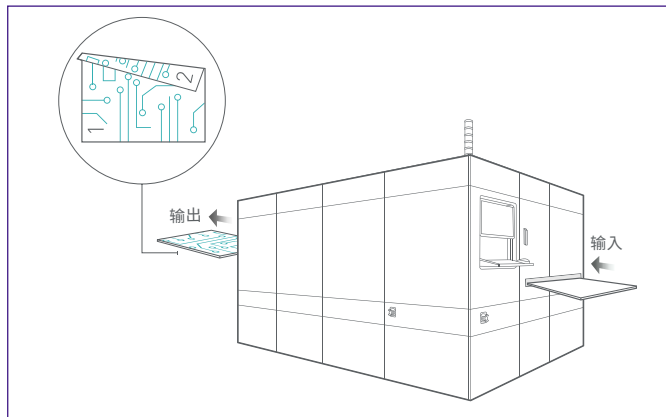


LSO™ Technology



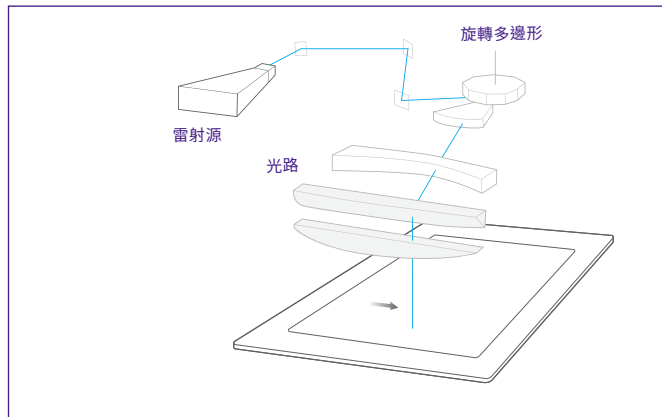
MultiWave Laser™ Technology

## 全自動雙面直接成像



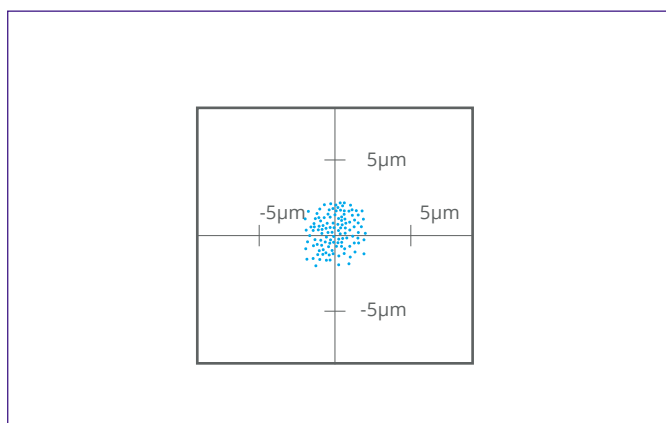
全自動，雙面直接成像解決方案，最大限度地提高了批量生產的產能和良率

## 高品質成像



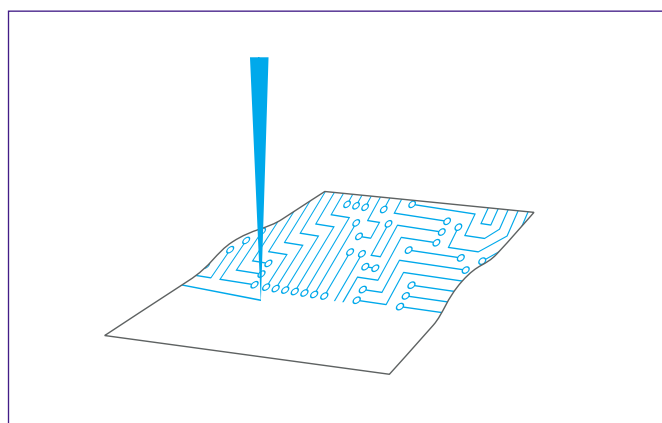
採用 KLA 經由市場驗證的 LSO™ (大鏡面掃描) 技術，單次曝光就能滿足超細線路成像

## 出色的對位精度



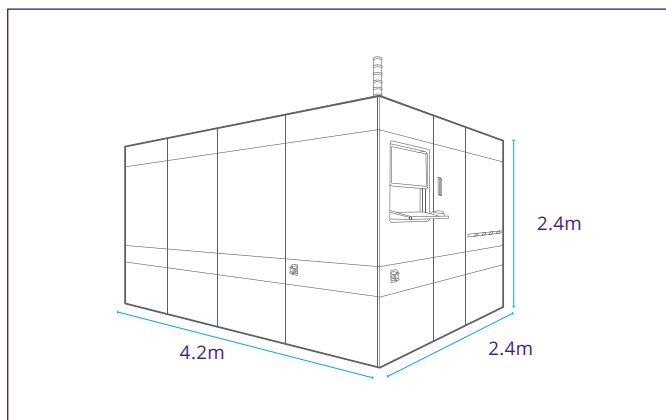
對位精度可精確至  $\pm 5\mu\text{m}$

## 高景深 (DOF)



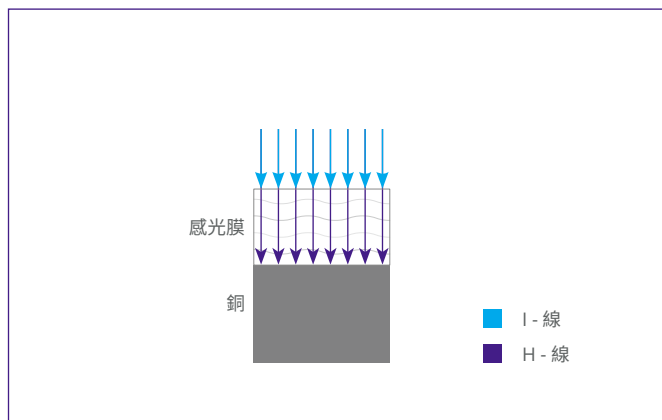
高景深 (DOF) 確保了在多種高低不均的板子上均能實現最佳的成像精度和均勻度

## 精巧的一體化設計



完全整合的解決方案結合其精巧、封閉的設計，乾淨環保的同時也提高了生產效率

## 支持多種感光膜



採用 KLA 經由市場驗證的 MultiWave Laser™ (多波長雷射) 技術兼容多種感光膜和製程

## 規格

### Orbotech Corus 8M

最小線寬 *	8μm
最小線寬+間距	20μm
邊緣粗糙度, 3σ	±1μm
對位精度 (FTG), 3σ	±5μm
層間對位精度	10μm
最大基板尺寸	660mm x 660mm (26" x 26")
最大曝光尺寸	635mm x 660mm (25" x 26")
尺寸 (l) x (w) x (h)	4.2m x 2.4m x 2.4m

\* 取決於感光膜特性和製程

#### KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、性能和生產率提升以及轉售認證設備。

KLA Corporation

[www.orbotech.com/pcb](http://www.orbotech.com/pcb) | [www.kla.com](http://www.kla.com)

Rev 9.0\_8-11-2022

© 2022 KLA 公司。所有品牌或產品名稱可能為其各自公司的商標。KLA 保留在不另行通知的情況下更改硬體和/或軟體規格的權利。